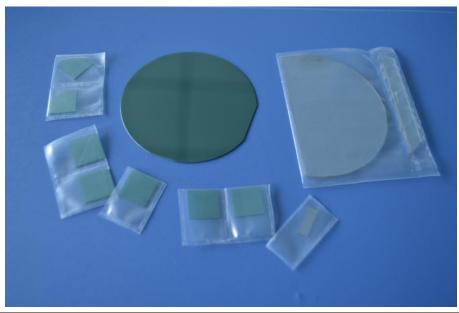


SiC



主要性能参数	
生长方法	MOCVD
晶体结构	六方
晶格常数	a=3.08 Å c=15.08 Å
排列次序	ABCACB
方向	生长轴或 偏<0001> 3.5 °
带隙	2.93 eV (间接)
硬度	9.2 (mohs)
热传导@300K	5 W/ cm.k
介电常数	e(11)=e(22)=9.66 e(33)=10.33
尺寸	10x3, 10x5, 10x10, 15x15, , 20x15, 20x20,
	dia2" x 0.33mm dia2" x 0.43mm 15 x 15 mm
厚度	0.5mm, 1.0mm
抛光	单面或双面
晶向	<001>±0.5°
晶面定向精度:	±0.5°
边缘定向精度:	2° (特殊要求可达 1°以内)
斜切晶片	可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角 1°-45°)
	的晶片
Ra:	≤5Å (5μm×5μm)
包装	100 级洁净袋, 1000 级超净室